

ECE認定プログラム コース

要素技術コース

要素プロセス技術1 リソグラフィコース		要素プロセス技術2 エッチングコース		要素プロセス技術3 成膜コース		要素プロセス4 組立コース	
1	フォトマスク作製 レーザー描画	4	シリコン異方性エッチング	13	パリレン薄膜形成 パリレン	6	陽極接合
2	精密リソグラフィ 両面マスクアライナ	8	シリコンドライエッチング D-RIE	14	金属薄膜形成1 ECRスパッタ	7	パッケージ
16	レジスト塗布 コータデベ	9	ガラスドライエッチングNLD	16	レジスト塗布 コータデベ	19	ウェーハ切断 ダイサー
17	転写プロセス ナノインプリント	15	加工表面観察	18	金属薄膜形成2 4元スパッタ	20	デバイス接合 アッシャー

デバイスコース1

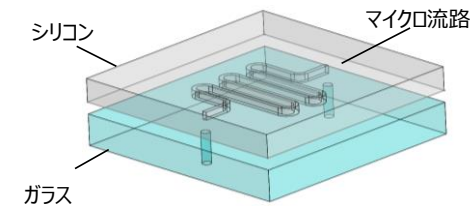
デバイスコース2

デバイス1 バルクマイクロマシニングコース (ナノ・マイクロ流路形成)	
3	シリコン酸化
4	シリコン異方性エッチング
5	ナノパターン形成
6	陽極接合

デバイス2 サーフェスマイクロマシニング コース (電極/配線形成)	
2	精密リソグラフィ 両面マスクアライナ
8	シリコンドライエッチング D-RIE
14	金属薄膜形成1 ECRスパッタ
16	レジスト塗布 コータデベ

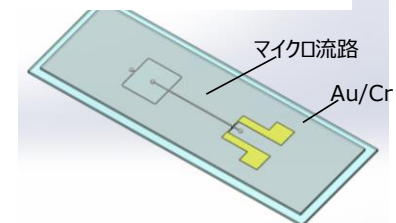
シリコンマイクロ流路の例)

実習はシリコンマイクロ流路形成と陽極接合



電極/配線の例)

実習はAu/Crスパッタとウェットエッチング



ECE認定プログラム

要素プロセス技術1, 2, 3, 4 デバイスコース1, 2

ECE認定基準

3/4以上受講

満たない場合、レポート (アンケート) 提出